

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】令和3年9月2日(2021.9.2)

【公開番号】特開2019-29346(P2019-29346A)

【公開日】平成31年2月21日(2019.2.21)

【年通号数】公開・登録公報2019-007

【出願番号】特願2018-138106(P2018-138106)

【国際特許分類】

H 05 B 3/00 (2006.01)

H 01 L 21/683 (2006.01)

H 05 H 1/46 (2006.01)

【F I】

H 05 B 3/00 3 1 0 A

H 01 L 21/68 N

H 05 H 1/46 L

【手続補正書】

【提出日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0032】

基板支持体106は、エッジリング180を備える。エッジリング180は、上部リングに対応してよく、上部リングは、底部リング184によって支持されてよい。エッジリング180は、1または複数の加熱素子188を備えてよい。したがって、温度コントローラ142は、セラミック層112の加熱素子188およびエッジリング180の加熱素子188の両方に供給される電力を制御してよい。本開示の原理に従った基板処理システム100において、温度コントローラ142は、後に詳述するように、(例えば、図1では図示していない共通フィルタモジュールと、電力供給ケーブル192とを含む)共有ケーブル・フィルタシステムを介して加熱素子144および188に電力を供給する。